

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

编号：2025-004

深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	初华投资、国诚投资、 东方财富、 金证投资、远东宏信、惠华控股、个人投资者 赖泽辉
时间	2025 年 5 月 30 日
地点	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 34 楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：冯学裕 董事会秘书、财务总监：蒋伟红 证券事务代表：陈远紫
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍公司基本情况和发展历程。 二、与调研机构的互动交流。 公司与调研机构方互动交流的主要内容如下： Q1、液冷技术主要应用在哪些领域？ 答：液冷技术主要应用于 AI 服务器、高性能计算等对散热性能要求极高的场景，并正向储能系统、新能源汽车等领域拓展。其优势在于散热效率高、能耗低，关键技术挑战包括系统密封性、导热效率、材料兼容性等。公司已建立液冷产品核心制造和验证体系，具备从结构设计、材料选型到系统集成技术能力，并持续推进在多元场景下的工程化应用。 Q2、当前液冷方案面临的主要技术难点是什么？公司是如何解决？公司的解决方案有何优势？ 答：（1）当前液冷方案在实际应用中主要面临以下几个技术难点： ①系统集成与可靠性问题：液冷涉及流体、电气与热管理的高度集成，容易引发泄漏、腐蚀、冷凝等问题，特别是在高密度、高功率的场景

	中，系统稳定性和安全性要求高； ②散热效率与成本平衡：虽然液冷散热效率高，但成本、能耗控制、运维复杂性也是挑战，尤其在大规模部署时； ③组件标准化与兼容性差：液冷产品在接口、连接件、维护工艺上缺乏统一标准，限制了产业规模化推广； ④长期运行可靠性验证不足：液冷系统相较风冷仍属于新兴方案，实际部署数据较少，市场对其长期可靠性、寿命存在顾虑。 （2）公司从两个方向应对上述挑战： ①自主开发高可靠性密封与防腐结构：采用先进制造专利技术，应用于散热板制造，显著提升产品的耐压与密封性能； ②结合算法优化液冷流道与热交换路径：自主开发新一代高效散热结构，通过优化流道与换热单元设计，有效提升导热效率与流体稳定性。 （3）公司液冷解决方案在以下方面具备明显优势： ①一体化结构设计，提高系统稳定性与散热效率； ②材料与结构性能优异，满足高功耗设备的严苛需求； ③具备较强的量产能力与成本控制优势，便于规模化推广。 Q3、公司液冷产品的市场前景？成本与毛利率水平预计如何？量产计划如何？产能能否跟上？ 答：（1）产品市场前景 随着 AI 服务器、高性能计算和数据中心等领域的对散热系统的性能需求日益增长，液冷散热技术逐渐成为行业发展的主流方向。液冷模块的单体价值不断攀升，系统级液冷解决方案预计将成为未来服务器整机制造商之间竞争的关键因素； 公司专注于液冷产品领域，该产品线正处于高速增长的赛道。凭借在技术上的独特优势，市场前景极为广阔，未来公司将围绕核心客户，不断推进技术革新、产品个性化定制以及应用领域的拓展。公司将致力于以“技术领先、快速响应和规模化交付能力”为核心竞争力，力争在下一代高性能散热技术中占据稳定的市场份额，并推动液冷业务成为公司新的增长点。 （2）成本与毛利率水平预计
--	---

	公司液冷散热产品运用自主研发的高性能生产工艺，与传统工艺相比，其制造成本更低，生产效率更高。随着产品规模化生产，成本优势将得以显现体现。 （3）量产计划与产能 目前，公司液冷产品已经成功完成多次内部技术验证，并且已经通过了部分服务器整机生产商的测试与认证，该产品正处于量产准备阶段。公司已在惠州新设生产基地，该基地的定位是公司新拓展的数字与热管理业务，未来公司将根据客户需求与配套项目地发展节奏，灵活地推进商业落地。 Q4、公司超级 SIM 卡的核心应用场景是什么？有何相比优势？如何推广？订单和盈利模式如何？ 答：公司超级 SIM 卡项目，其核心应用场景是以手机 SIM 载体为基础，使用手机 NFC 识别检票信息，通过闸机完成检票过程，用户实现无感通行，是一种新的过闸机验票方式，为出行提供方便。由于传统身份证检票存在体积小，易遗失风险，超级 SIM 卡可大幅提升旅客的通行效率和出行体验。 项目推广依赖于国内运营商和铁路部门的紧密合作，正在试点应用阶段。项目盈利模式包括卡销售、套餐分成、增值服务等三方面，在功能拓展和附加值提升等方面，超级 SIM 卡相较于传统智能卡具有明显优势，市场发展潜力更为广阔。目前公司与国内主要运营商建立了稳定且深入的合作关系，持续推动超级 SIM 卡在更多垂直场景中的应用落地，以提升产品价值、拓展业务范围，并为后续规模化复制与推广打下坚实基础。 Q5、引线框架业务增长原因及半导体业务整体规划？ 答：（1）引线框架业务增长原因 引线框架作为半导体封装材料的重要组成部分，广泛应用于功率器件、模拟器件、逻辑器件及第三代半导体等领域。目前，引线框架行业市场整体保持良好增长趋势，得益于下游应用持续扩展，尤其是新能源汽车电控系统、MOSFET、IGBT 功率模块、光伏逆变器及服务器领域，对中高端引线框架需求快速增长，高导热、高电流承载、低热
--	--

	阻特性逐步成为客户标准要求，行业不断向更高性能规格迭代升级。此外，受益于全球供应链重构，国内引线框架厂商在中高端应用领域的机会显著增加。 公司基于精准的市场判断，提前布局了引线框架业务，并实现了产销规模与营收的快速增长。2024 年引线框架产品收入同比增长 467.80%；2025 年一季度引线框架产品收入同比增长 236.78%。 （2）半导体业务整体规划 公司半导体封装业务聚焦于高性能封装材料的自主研发，核心产品包括：专用芯片引线框架、功率半导体引线框架和 SiC 和 IGBT 模块散热底板。未来公司将以新能源汽车、数字能源、高端工业控制、第三代半导体等快速增长领域为导向，聚焦核心客户与关键应用场景，重点推动如下方向：①加速散热底板等产品投产，推进 SiC 和 IGBT 模块封装材料解决方案落地；②拓展头部功率模块客户及其工装配套链；③深化国内外市场布局，扩大市场份额，推动半导体业务成为新的业绩增长引擎。 Q6、公司近两年智能卡业务收入持续下滑，今年预期如何？ 答：从今年上半年来看，智能卡业务有明显回暖，行业库存的调整工作已基本完成，由于部分海外客户面临关税方面的挑战，促使业务需求增加，公司凭借在印度和印尼的海外生产基地，能够实现快速交付。国内市场方面，公司持续深化与国内主要电信运营商的战略合作关系，并积极参与招投标活动，以稳固其市场份额。 Q7、智能卡业务的国内外市场结构？增长情况如何？关税战对公司的影响？ 答：海外业务为公司核心战略支柱，收入占比长期超 60%，主要通过印度新德里及印尼雅加达两大生产基地交付，海外两大生产基地运营稳健。近年来公司在国内努力争取与四大运营商长期合作，持续保持招标份额，国内市场的开拓成为公司新的利润增长空间。截止目前公司没有直接向美国出口或采购的情况，关税战对公司影响较小。 Q8、智能卡与液冷业务是否有协同作用？未来是否考虑并购？ 答：智能卡与液冷业务技术路径和客户群体差异较大，暂无直接协同。
--	---

	未来公司将聚焦现有主业，同时也密切关注新拓展业务产业链上下游优质标的，对行业内并购机会保持持续关注，公司将在充分评估风险和收益的前提下，结合行情变化及公司发展需求谨慎决策并适时考虑。 Q9、公司在液冷业务方面与华为合作可能性？ 答：目前公司尚未与华为在液冷业务领域建立合作关系。若未来相关业务涉及与华为的合作，公司将严格遵循保密协议约定及客户合规要求，严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规要求履行信息披露义务。 Q10、公司业务发展是否有融资计划？ 答：基于公司业务发展情况，未来将根据业务拓展的需要进行审慎评估。如公司有扩产或其他重大融资活动，公司将及时依据法律法规要求进行信息披露。 Q11、公司现金流情况？汇率波动影响？ 答：目前公司现金流充足，资产负债率相对较低。公司产品外销占比超过 60%，在美元兑人民币汇率提升情况下，对公司业绩有一定积极的影响。 Q12、2025 年一季度业绩高增长原因及公司全年展望？ 答：公司一季报业务收入增长原因如下： （1）持续加大智能卡产品销售力度，多维度拓展国内外市场，收入同比增长；（2）公司已实现半导体封装材料（引线框架）的自主设计与量产落地，产品可覆盖 MOSFET、IGBT、SiC 及功率模块的封装需求，订单量增加，收入同比增长 236.78%； 2025 年公司紧紧围绕经营目标，整体看公司将延续增长动能：在智能卡方面深化国内运营商合作，拓展超级 SIM 卡应用场景；加大半导体封装材料的市场拓展力度，积极向头部功率模块及工装企业推广铜针式散热底板产品；公司液冷与封装材料产品具备结构创新和成本优势，随着客户的导入及量产计划推进，有望在核心客户放量下实现快速成长。
风险提示	公司提醒新业务新产品开发过程中存在一定的技术风险、市场风险和

	应用验证周期风险，上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
附件清单 (如有)	无
日期	2025-5-30